

ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಭಾರತ-U.S. AI ಅವಕಾಶ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026

2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಫೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಫೋಷಣೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಅನುಬಂಧವಾಗಿ "ಭಾರತ-US AI ಅವಕಾಶ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ಕುರಿತ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

2. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್; ಭಾರತಕ್ಕೆ US ರಾಯಭಾರಿ ಶ್ರೀ ಸೆರ್ಜಿಯೋ ಗೋರ್; ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ US ರಾಜ್ಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜಾಕೋಬ್ ಹೆಲ್ಮ್‌ಗ್ ಆವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ರೈಲ್ವೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮತ್ತು US ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿ ಕಚೇರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ರಾಟಿಸ್‌ಯೋಸ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ನಡೆದಿದೆ.

3. ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಇರುವ ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವು ಭಾರತ-US ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಿತಿತ್ವಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲಿನ ತೊಡಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

4. ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರವೇಶವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಾತ್ಮಕವೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು ಎಂದು ರಾಯಭಾರಿ ಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಆಳವಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

5. ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಪಾಲುದಾರರು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹರಡುವ ಹೊಸ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, AI ಯ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಲ್ಮ್‌ಗ್ ಹೇಳಿದರು.

6. ಸಹಿ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಲ್ಮ್‌ಗ್ ಅವರ ಸಂಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ರಾಯಭಾರಿ ಗೋರ್, ಮೈಕ್ರಾನ್ CEO ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ CEO ಡಾ. ರಣಧೀರ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

7. ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ AI ಯುಗದ ಅಡಿಪಾಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ-ಚಾಲಿತ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ.

8. AI ಅವಕಾಶ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಭೌತಿಕ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು AI ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು; ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು; ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು; ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು; ಮತ್ತು AI ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

9. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರವು ಭಾರತ-US ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿದ್ಧ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನವದೆಹಲಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026